

**Samsung NVMe SSD「970 EVO Plus」に対応した
セパレートタイプのヒートシンクを
ITG マーケティングより発売**

ITG マーケティング株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役社長: 左京 恒夫)は、Samsung NVMe SSD「970 EVO Plus」および「970 EVO」に対応した、セパレートヒートシンク「SMOP-SHS」を2019年9月13日(金)より発売いたします。

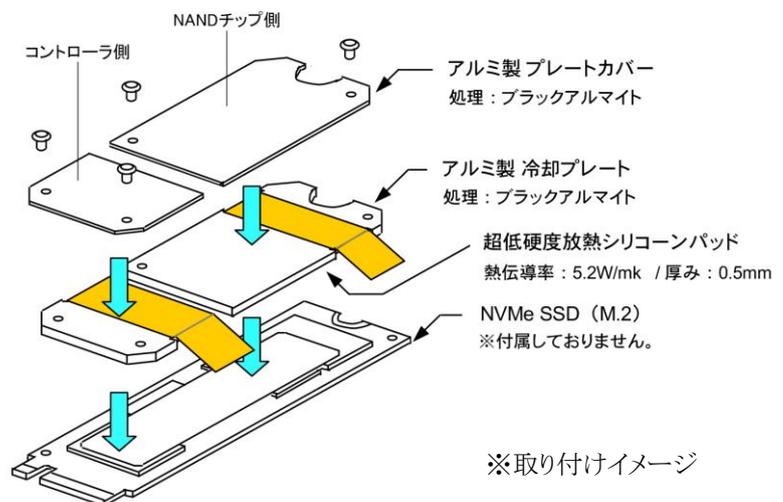


セパレートヒートシンク SMOP-SHS

■セパレートヒートシンクについて

インターフェース規格上、従来の SATA SSD に比べて高速動作が可能な NVMe SSD では、性能を維持するために適切な放熱対策が求められます。熱源となるコントローラや NAND チップの効率的な放熱手段として、サムスン是最適なエアフローを推奨しておりますが、ヒートシンクと併用することでより効率的な放熱が期待できます。

本製品は、より高温になりやすいコントローラ側から NAND チップ側への熱干渉を抑えるべく、セパレートタイプのオリジナルヒートシンクとして長尾製作所 (<http://www.nagao-ss.co.jp/>) に設計いただきました。



■製品特長

- ・SSD のコントローラと NAND を別々に冷やすセパレートタイプ
- ・Samsung NVMe SSD 「970 EVO Plus」および「970 EVO」に対応
- ・冷却プレートに放熱性の高いアルミニウム(2mm 厚)を採用
- ・信越化学工業製のシリコンパッドを採用(熱伝導率 5.2W/mK)
- ・安心の国内設計および国内生産

■ヒートシンクの外形寸法(最大値)

コントローラ側: W22.8mm × D21mm × H4mm

NAND チップ側: W22.8mm × D53mm × H4mm

※冷却プレート、プレートカバー、固定用ネジを含めた大きさです。

■内容物

- ・アルミ製 冷却プレート・・・2 枚
- ・アルミ製 プレートカバー・・・2 枚
- ・耐熱絶縁テープ・・・2 枚
- ・放熱シリコンパッド・・・2 枚(冷却プレートに貼り付け済み)
- ・プレートカバー固定用ネジ・・・4 本
- ・取扱説明書

■注意事項

- ・ヒートシンクの効果につきましては使用環境により異なります。
- ・取り付け環境によっては、他のパーツとの干渉により取り付けが困難な場合がございます。
- ・製品の製造工程において軽微な擦り傷、若干のメッキムラが生じてしまう場合がございます。
- ・切断面のバリ取りは入念に行っていますが、取り付けの際は怪我のないよう十分にご注意ください。
- ・本製品の使用により SSD 本体およびラベルやバーコードに損傷が生じた場合、SSD 製品の保証が適用されない場合がございます。

■製品ラインナップ

製品	型番	価格
セパレートヒートシンク	SMOP-SHS	オープンプライス

-
- ・本プレスリリースに掲載されている会社名および製品・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。
 - ・本プレスリリースに掲載されている内容、サービスならびに製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。